

材料学院材控 10 届 复试

很多人认为复试不重要，其实初试成绩除以 5 再乘以 60%之后大家都相差不多，而复试

真正能拉开很大的距离的，所以复试也不能掉以轻心，下面我稍稍介绍下复试的情况，希

望对 2011 材控考研的学弟学妹们有所帮助。

复试分为两个部分，笔试和面试

笔试开始有六道题。第四、五题是微机原理的，我也没看，其他的是材料成型原理和工艺

两本书上的，还有一道送分题。（六选三）题目如下：

1. 材料有哪几类，各有什么特点，应用范围？
2. 简述冲压工艺的原理，特点，及应用范围。
3. 列举获得细等轴晶的常用方法。
- 4/5 是微机原理的
6. 读研的原因，打算，以及与本科段的区别（送分题）

笔试还有一个翻译，大概在 100 字左右，我们考的好像是微型铸造与封装（不知道我看懂没），句子不难，就是有些专业词汇不认识。

下面就是面试了

开始有个思想素质面试，就是学工组的几位老师和几个学生问你几个问题，一般就是自我介绍，家庭情况啊等的，基本上就是走过场。

后面还有三个面试，分别是英语组，专业组和基本技能组。

1. 英语面我们还是比较幸运的，没有听力，就是有一个自我介绍，然后简单的几个问题。

建议自我介绍不要太长，一般老师都会打断你的自我介绍，问问题，问题主要集中在导师

的情况上，所以要对你你的导师及研究方向有所了解，还有一个好像是对导师的印象。本

校的基本上就是这些，一般不会太难。（呵呵，好像有个工作回来的，老师还问他职业规

划等）

2. 基本技能组就是开始一个简短的自我介绍，运气好的就是问问毕业设计的问题，运气不

好可能就要画图了，像铁碳相图啊，应力应变相图啊，听说还有老师叫别人画两个圆距的

相贯线，螺纹等。

3. 专业知识组。就是有很多题目，从中抽取一道来回答。题目一般都是材料成型原理和工

艺两本书上（当然考微机原理的还可以选择微机原理的题），一般老师开始会问你擅长于

哪一方面，然后为给你相应方面的问题来抽。在前面的会吃点亏，题目只有那几道，后面

回答的基本上所有的题目都已经知道了。（如果抽到的题不会，一般老师都会让你重抽）

下面我就把我记得的一些题目写下来

- 1) 屈服准则的定义与两种准则的比较
- 2) 激光焊的原理，工艺，特点，应用范围
- 3) 塑性成型对组织及性能的形象
- 4) 铸造合金为什么用共晶合金。
- 5) 铸造成型的特点
- 6) 半固态成型的特点
- 7) 流动性及充型能力的比较
- 8) 凝固结晶的定义，影响因素。
- 9) 等温锻造的定义，特点，应用范围。
- 10) 镦粗三原则
- 11) 塑性指标
- 12) 冲压原理，特点，范围
- 13) 塑性变形中的几个方程

我所记得的就这些了，希望其他人补充补充。

最后预祝 2011 年材控的学弟学妹们考研成功

补充：1、模膛布置的原则，制坯模膛的布置原则

2、预锻模膛的作用，预锻模膛的设计要点

3.密度偏析

4. 缩孔缩松哪个更容易去除？

5. 析出性气孔？形状？以及什么时候是什么形状